

成膜・表面改質・評価技術の最新動向

表面処理技術や評価技術、話題となっている製品、材料、加工技術等に関する幅広い情報の提供や大学等の研究シーズの発信を行うとともに、企業連携につながる研究テーマの発掘を目的としたセミナーです。

令和8年 11月19日 木 15:00 ▶ 16:30 参加無料

講演1 「ユニバーサルめっきによる金属成膜とその応用に向けて」

立命館大学 総合科学技術研究機構 教授 高橋 勲 氏

ウェットとドライプロセスのハイブリッドであるユニバーサルめっきを用いて、銅、ニッケル、白金等の金属の成膜事例についてご紹介します。ユニバーサルめっきはミストCVDを独自に改良した技術で、大気圧成膜のため高い生産性で低コストに各種酸化膜や金属膜が形成できます。

本講演では、次世代の半導体パッケージに利用されるガラスコア基板の銅成膜について、物性や密着性の評価を行った結果や、結晶成長用のルツボに貴金属をコーティングした結果等を報告します。

【キーワード】コーティング、銅めっき、ミストCVD、貴金属、機能性膜

講演2 「レーザ加工技術の応用展開 ～表面改質から半導体パッケージの信頼性評価事例～」

株式会社クオルテック 新規事業開発部 池本 裕 氏

当社は創業以来、プリント基板のビルドアップ工法の開発を通じてレーザ加工技術を培ってきました。時代の要求に合わせて、加工の微細化に取り組むだけでなく、その技術を表面改質分野にも展開し、めっき密着性の向上などの研究開発や各種信頼性評価を推進しています。また、近年ではレーザ技術を活用したパッケージ基板の新たな信頼性評価手法も提案しています。

本講演では、非加熱レーザ加工の導入事例をはじめ、表面改質への応用や先端半導体パッケージ評価への活用事例を中心にご紹介します。

【キーワード】非加熱レーザ加工、めっき密着性、半導体パッケージ評価

開催方式

会場 及び オンライン (Zoom) 併用

会場所在地：京都府産業支援センター 5階研修室

(京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内)

定 員

会場：30名 オンライン：70名

申込方法

当センターHPからお申込みください。

<https://www.kptc.jp/seminar/261119surface/>

問合せ先

京都府中小企業技術センター 応用技術課 表面構造係

TEL 075-315-8634

E-mail surface@kptc.jp



申し込みはこちらから